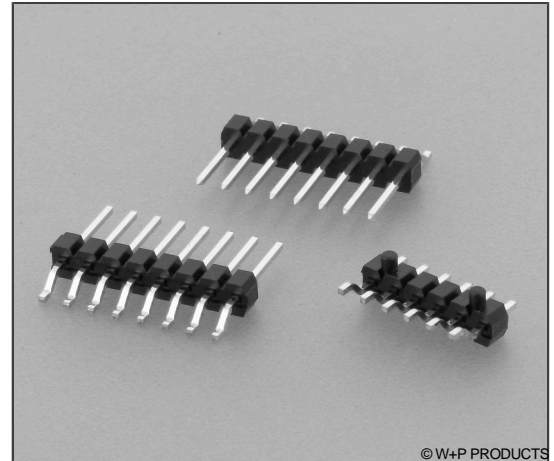


### Technische Daten / Technical Data

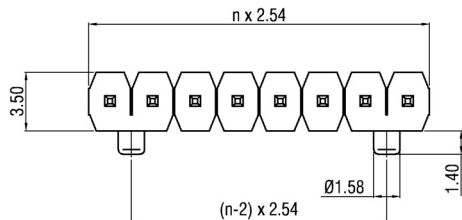
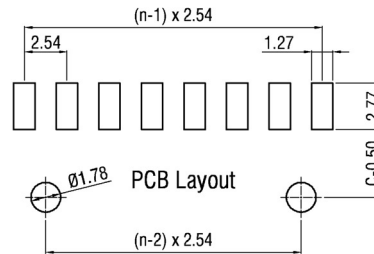
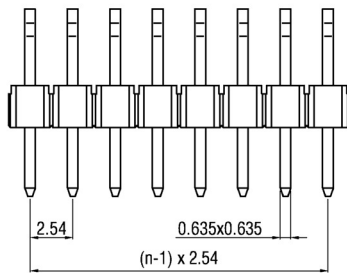
Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung <i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	3 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

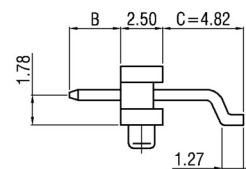
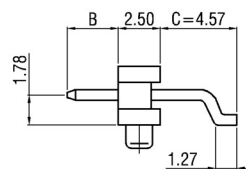
Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**3882** etc.

Weitere siehe Kapitel B  
*Please see ch. B for more*



Type A

Type B



Series	Contacts*	Type*	Dimensions*	Plating*	Locating Pegs*	Packaging*
<b>9631</b>	<b>08</b> 02-30 Einreihig <i>Single row</i>	<b>1</b> 1 Type A 2 Type B	<b>13</b> 13 B=3,05mm 14 B=5,84mm 15 B=8,13mm 16 B=10,67mm 99- Kundenspezifisch <i>Customer-specific</i>	<b>50</b> 00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i> 60 Sel. Au/Sn <i>Duplex plating</i>	<b>00</b> 00 Ohne Pos.hilfen <i>W/o loc. pegs</i> 10 Mit Pos.hilfen <i>With loc. pegs</i>	<b>PPST</b> ST PPST PPTR (Option)

### Lieferformen / Packaging Options:

**ST** In Stangen ohne Pick&Place-Pads / *In tubes w/o Pick&Place-Pads*

**PPST** In Stangen mit P&P-Pads / *In tubes with P&P-Pads*

**PPTR (Option)** Tape & Reel mit P&P-Pads / *Tape & Reel with P&P-Pads*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

